

杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于部分募投项目增加实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日、2026年9月21日分别召开第五届董事会战略委员会第十次会议、第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期）”的原实施地点到位前，增加公司现有位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园地块AC503的3号厂房的租赁场地作为该募投项目的实施地点，先行开展铜基钎料部分产线建设工作以满足市场需求。本事项不涉及募集资金用途变更，募投项目其他内容不变，无需提交股东会审议。公司保荐人中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）4,893,041股，每股发行价格为40.67元，募集资金总额为198,999,977.47元，扣除各项发行费用5,388,510.78元，实际募集资金净额为193,611,466.69元。前述募集资金已于2026年3月9日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司及全资子公司华光焊接新材料（泰国）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定

对象发行股票募集说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期）	24,930.00	19,900.00
合计		24,930.00	19,900.00

三、本次部分募投项目增加实施地点的具体情况

公司募投项目“泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期）”原实施地点位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园 TC55+TC59+TC59/1 地块，尚待自建厂房，为积极响应海外市场需求的快速增长，公司决定在该募投项目原实施地点到位前，增加公司现有位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园地块 AC503 的 3 号厂房（地址：Amata City Rayong 7/602 Moo 6, Map Yang Amphone Subdistrict, Pluak Daeng District, Rayong Province）的租赁场地作为该募投项目的实施地点，先行开展铜基钎料部分产线建设工作以满足市场需求。

公司将持续推进募投项目原实施地点泰国泰中罗勇工业园的相关厂房建设，待自建厂房建设完毕后，将上述募投项目搬迁至自建厂房，实施募投项目。除上述项目新增募投实施地点外，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额、募集资金用途等均不存在变化。

四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响

本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设实际需要的审慎调整，不影响公司募投项目的正常实施，有利于提升募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。

五、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 9 月 18 日、2026 年 9 月 21 日分别召开第五届董事会战略委员会第十次会议、第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，本事项无需提交股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司董事会战略委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施地点事项无异议。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026年9月22日